

証券コード:6590 (東証プライム)

芝浦メカトロニクス株式会社 個人投資家様向け会社説明会



芝浦メカトロニクス株式会社

代表取締役社長 今村 圭吾

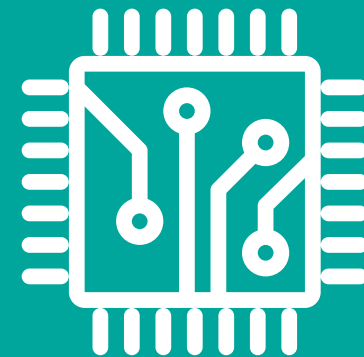
2024年12月18日

Contents

01 企業概要と特長

02 当社が注力するSPE分野と業績推移

03 長期ビジョン及び中期経営計画



01

企業概要と特長

会社概要

当社は、車や電子機器、スマートフォンやタブレット端末など、私たちの身近にある“モノ”に必要な**半導体**や**フラットパネルディスプレイ（FPD）**などをつくるための**製造装置**や、**真空応用装置**などを開発、製造、販売しています。

現在の主力は半導体製造装置で、**ニッチ（特定）分野**における**世界市場でトップ**を目指す**グローバルニッチトップ^o（GNT）製品**が、お客様の工場で活躍しています。

創業

1939年

本社・工場

神奈川県

(横浜市、海老名市)

連結従業員数

1,211名

(2024年3月末)

連結子会社

国内外9社

国内外拠点

42拠点

(サービス拠点含む)

資本金

67.6億円

売上高*

676億円

営業利益*

116.9億円

ROS *

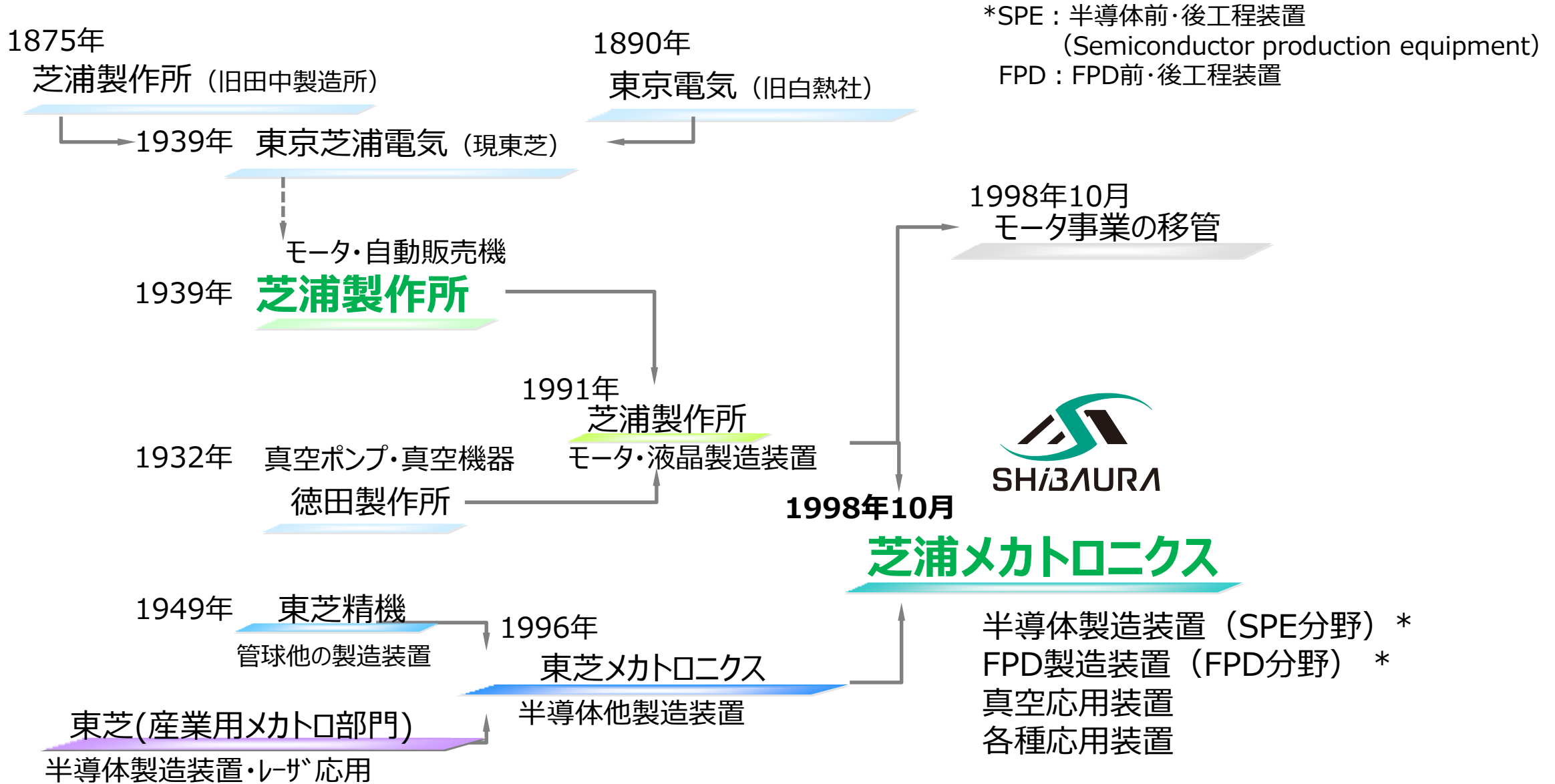
17.3%

ROE *

24.5%

*2023年度実績

沿革



事業分野

2+2+1の5つの事業分野と、これらの国内外保守サービス業務を担う

ファイン
メカトロニクス
セグメント

SPE分野
前工程装置



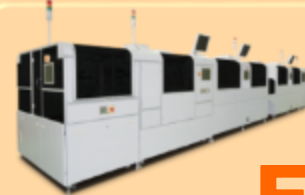
FPD分野
前工程装置



メカトロニクス
システム
セグメント



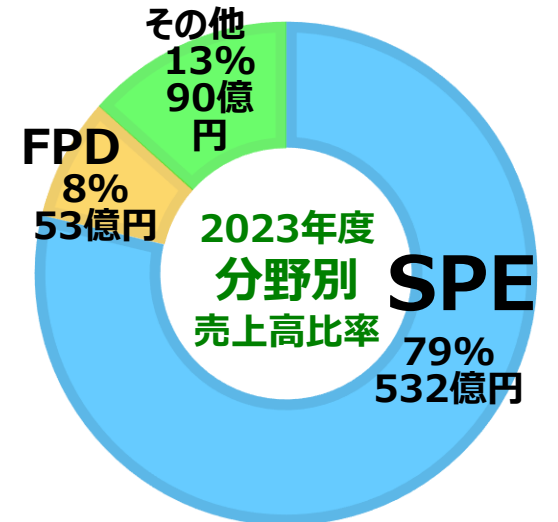
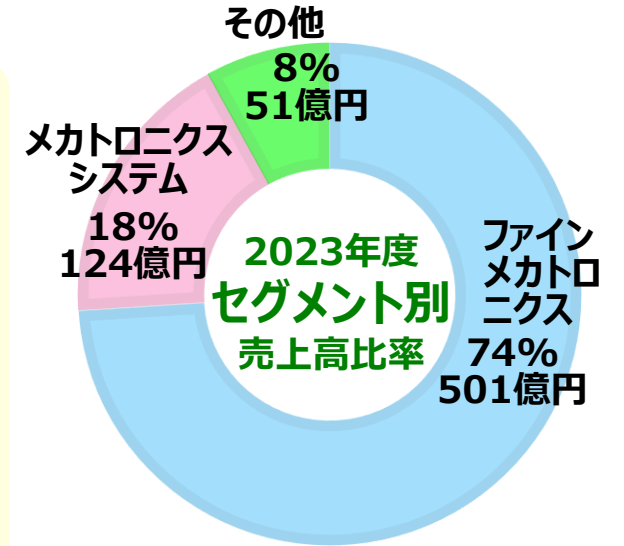
SPE分野
後工程装置



FPD分野
後工程装置

**真空応用
装置**

その他セグメント
・流通機器システム
・不動産賃貸



主な販売先

製品・サービスの仕向地は**海外が6割以上**
顧客の投資先により、当社の仕向地も変化

*1 ファウンドリ：半導体前工程製造を受託する業態

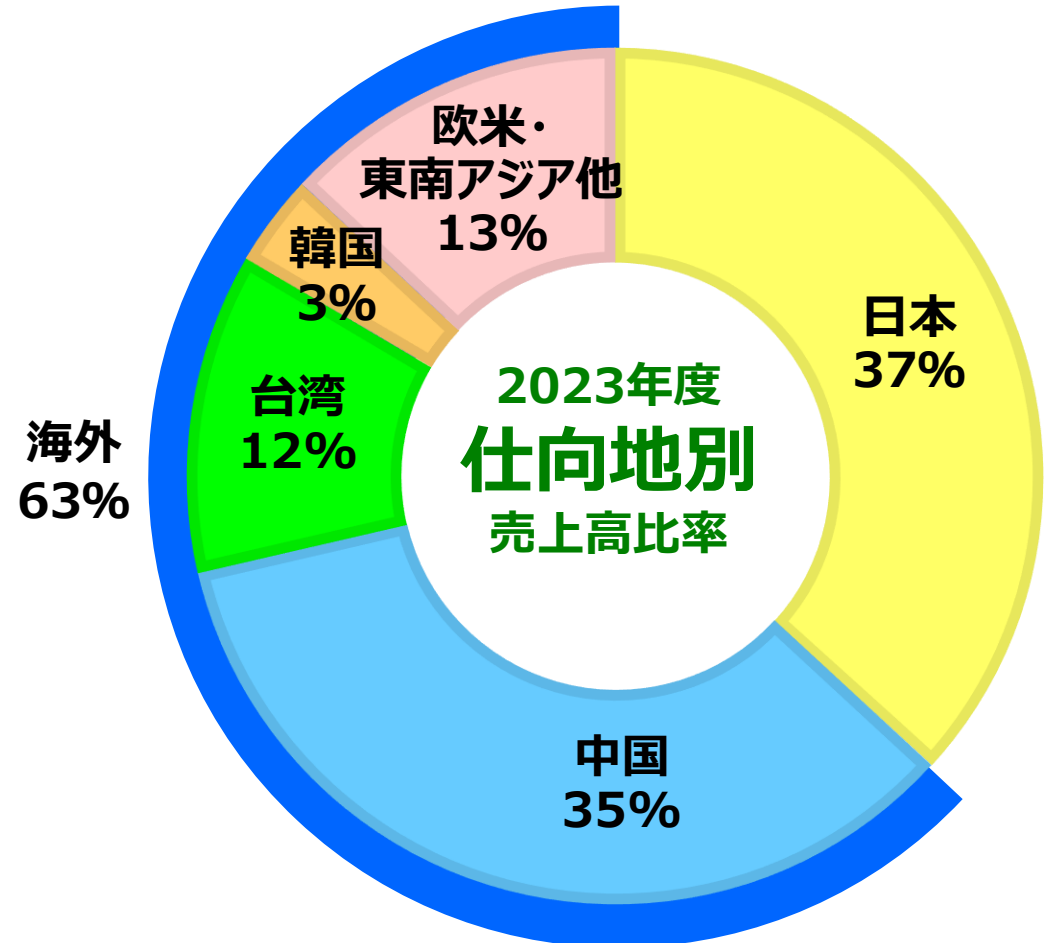
*2 OSAT：Outsourced semiconductor assembly and test
半導体の後工程製造（組立・テスト）を受託する業態

SPE分野

ウェーハメーカー
フォトマスクメーカー
デバイスメーカー
ファウンドリ^{*1}
OSAT^{*2}

FPD分野

パネルメーカー



関係会社ご紹介

芝浦エレテック 国内サービス

国内12拠点展開

- ・芝浦メカトロニクス装置関連
- ・芝浦エレテック製品関連
- ・他社製中古半導体製造
装置リファビッシュ
- ・異業種関連保守・サービス



海外現地法人 当社製品販売・サービス

- 【中国】芝浦机电(上海)
- 【台湾】台湾芝浦先進科技
- 【韓国】韓国芝浦メカトロニクス
- 【アメリカ】SHIBAURA
TECHNOLOGY
INTERNATIONAL
CORPORATION

芝浦自販機 券売機・自販機事業

国内9拠点展開

- ・券売機（外食チェーン店、
水族館等施設他多数）
- ・汎用自販機（おもちゃ、
トレカ・金券・チケット等）



キャッシュレス対応
券売機



大小ボックス商品
汎用自販機

その他の関係会社

- 芝浦プレジジョン
部品加工
- 芝浦エンジニアリング
施設管理・工事、印刷・デザイン等
- 芝浦ハイテック
施設管理（小浜地区）

強み・特長

1. 当社の歴史の中で培った複数のコア技術が各分野で活かせる

精密メカトロニクス、洗浄、ボンディング、エッチング、真空、成膜など

2. 前工程・後工程両方の工程向けの製品、技術を持つ

SPE分野、FPD分野、両方の製造装置を取り扱うメーカーは多いが、前工程、後工程向け両方の製造装置を扱うメーカーは珍しい

3. ニッチ市場、ニッチ工程ながら先端の製品、トップシェアの製品を持つ

SPE前工程（例）：枚葉式Si（シリコン）ウェーハ洗浄装置★
枚葉式リン酸エッチング装置★

SPE後工程（例）：高精度2.5Dボンダ★
超高精度ハイブリッドボンダ

★：一部特定の工程・用途向けで
トップシェア（当社調べ）の機種あり

4. 顧客に寄り添う技術開発力と人財

顧客ニーズに寄り添う先端技術開発、最後までやりきれぬ人財



02

当社が注力するSPE分野と業績推移

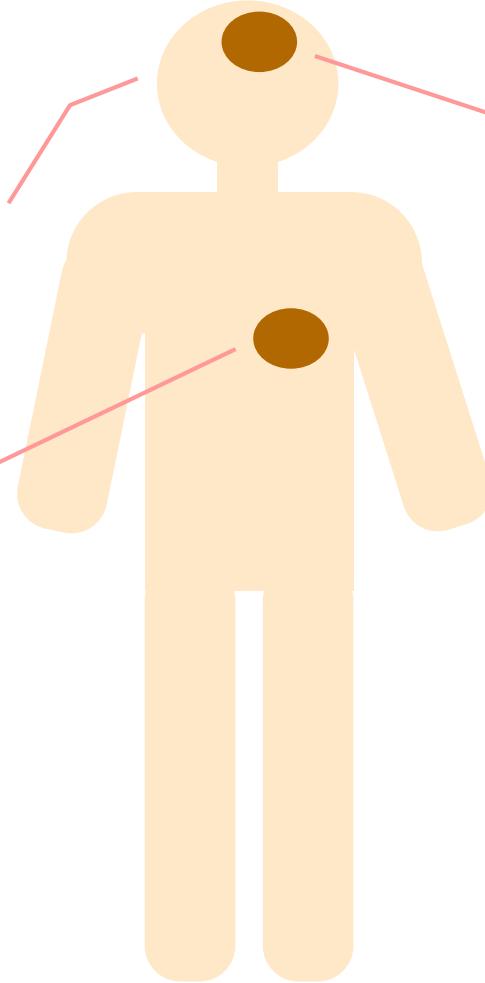
半導体製品の役割イメージ

<感覚器官…アナログ>

光や音などの非連続的な電気信号を処理・制御。
音響機器や無線のほか、光や温度、圧力といったセンサーシステムなど、身近な機器でよく使われている。

<心臓…ディスクリート>

信号の増幅や電力の制御など特定の機能に特化。
パワーデバイスもディスクリート半導体で、大きなモータを駆動させるため電力を制御・供給したり、小さな電力をCPUやセンサなどに送り込む役割も。



- *1 CPU…中央演算処理装置 Central Processing Unit
GPU…画像処理装置 Graphics Processing Unit
- *2 DRAM…動的ランダムアクセスメモリ
Dynamic Random Access Memory
NAND…NAND (Not AND) 型フラッシュメモリ

<頭脳（思考）…ロジック> *1

CPUで複雑な計算処理、指令
GPUで単純で大量の計算処理、
画像描画処理

<頭脳（記憶）…メモリ> *2

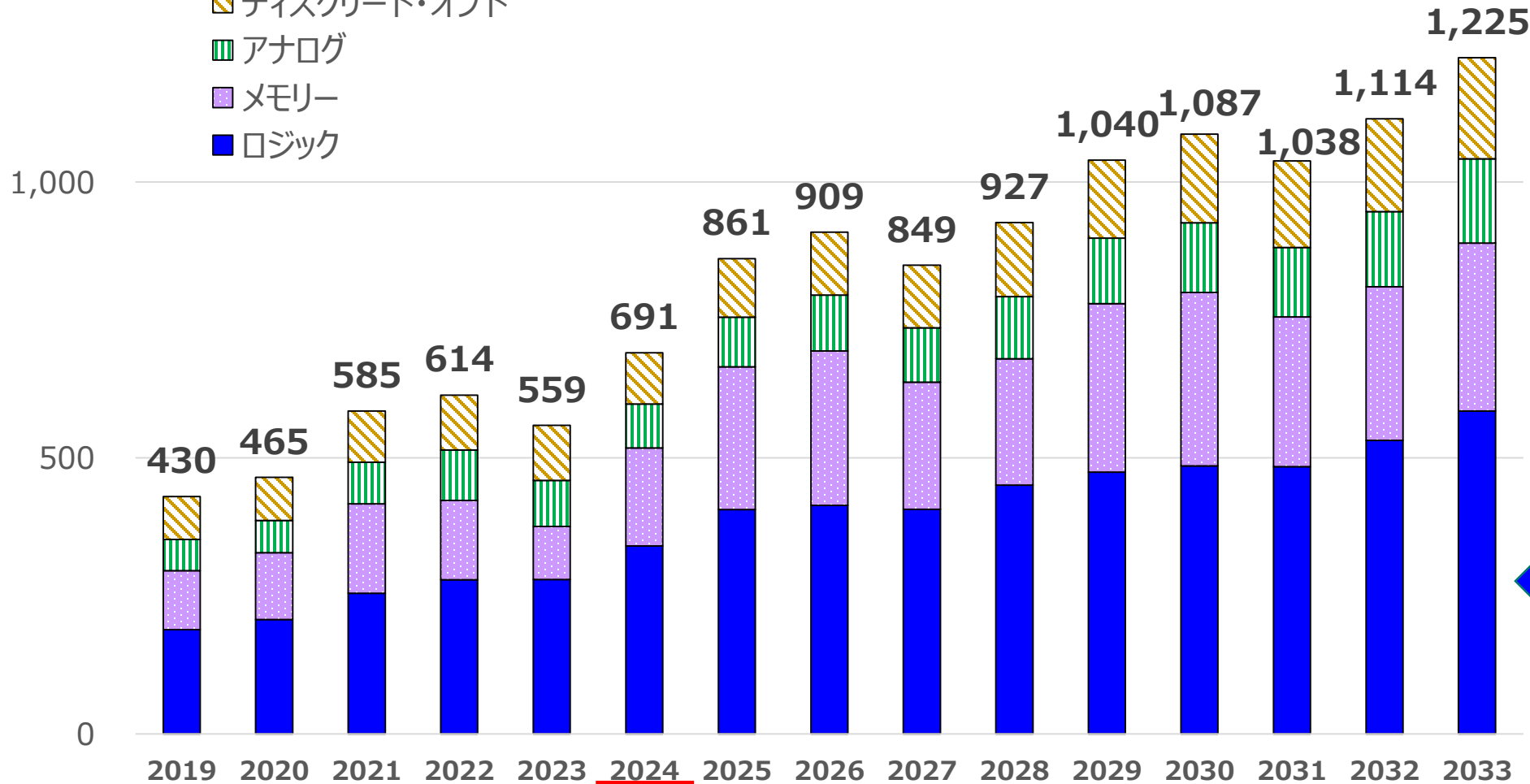
情報を電氣的に格納して蓄積
(短期記憶：DRAM、長期記憶：NAND)

半導体製品売上高 市場予測

(単位：10億US \$)

*出典：TechInsights Inc. 2024-10
(暦年、グラフは当社にて作成)

- ディスクリート・オプト
- アナログ
- メモリー
- ロジック



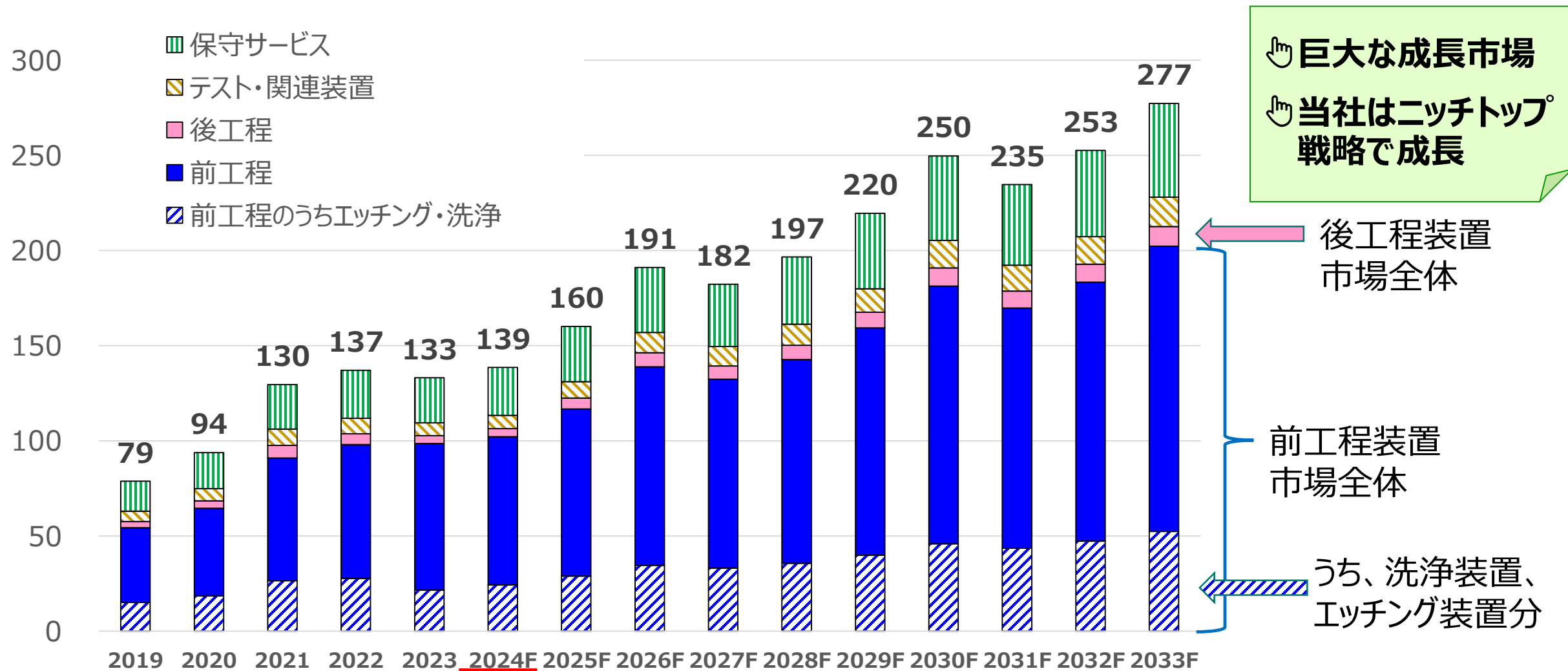
👉 巨大な成長市場
👉 当社は先端ロジック
向けのお客様中心
に参入

← 当社の製造装置
も多数使われている、ロジック製品の
世界市場規模

半導体製造装置売上高 市場予測

(単位：10億US \$)

*出典：TechInsights Inc. 2024-10
(暦年、グラフは当社にて作成)



👉 巨大な成長市場
👉 当社はニッチトップ戦略で成長

← 後工程装置市場全体

← 前工程装置市場全体

← うち、洗浄装置、エッチング装置分

当社が注力するSPE分野（1）

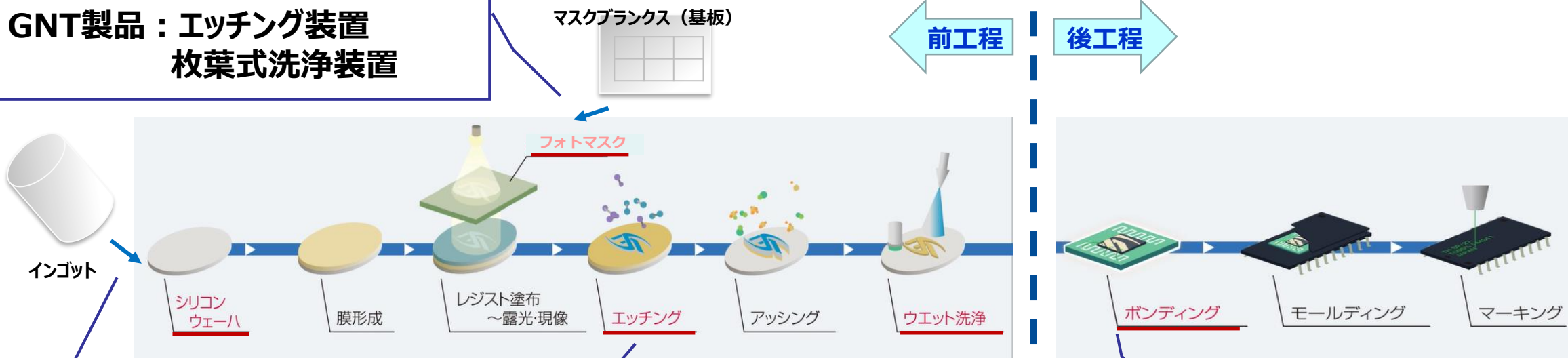
*GNT製品：当社グローバルニッチトップ対象製品群

フォトマスク製造

ガラスなどの透明な基板を、ウェーハに転写する回路パターンの“原版”に加工する工程

**GNT製品：エッチング装置
枚葉式洗浄装置**

4つの製造工程のニッチなプロセスで、**グローバル**に活躍できる製品群
グローバルニッチトップ製品（GNT製品）で**先端分野**に注力



Siウェーハ製造

半導体の材料となるシリコンなどを、インゴットからウェーハに加工する工程

**GNT製品：枚葉式洗浄装置
（研磨後洗浄、最終洗浄など）**

ウェーハプロセス（デバイス製造）

ウェーハ上に回路パターンを形成する工程

**GNT製品：枚葉式リン酸
エッチング装置**

モジュールプロセス

ウェーハ上に形成された回路パターンをチップ単位に切り出し、パッケージに加工する工程

GNT製品：高精度フリップチップボンダ

当社が注力するSPE分野（2）

★：一部特定の用途・工程向けでトップシェア（当社調べ）の機種あり

工程	GNT製品	代表的用途	強み・特長
Siウェーハ製造	枚葉式洗浄装置★	Si（シリコン）など半導体の材料となるウェーハ	より微細な異物が除去できる枚葉式に特化し、各工程間・最終洗浄工程に対応。独自の洗浄技術で安定した高い洗浄性能を実現。
フォトマスク製造	・エッチング装置 ・枚葉式洗浄装置	半導体の回路パターン原版となるフォトマスク	従来のフォトマスクから、最新の次世代EUV用フォトマスクまで幅広く対応。 洗浄装置では、フォトマスク上のパターンにダメージを与えない凍結洗浄技術搭載の新機種を上市。
ウェーハプロセス (デバイス製造)	枚葉式リン酸エッチング装置★	CPU、GPUなどの先端ロジック製品	独自のヒーター技術でウェーハ表面の窒化膜厚のエッチング量の分布を緻密に制御。エッチングに使用するリン酸はリサイクルが可能。
モジュールプロセス	高精度フリップチップボンダ★	GPU、AIチップなど各種先端パッケージ	急速に市場拡大する生成AI用GPU用ボンダから、さらに進化を続ける先端パッケージに向けた各種ボンダを幅広くタイムリーに開発。

業績推移及び2024年度予想 (1)

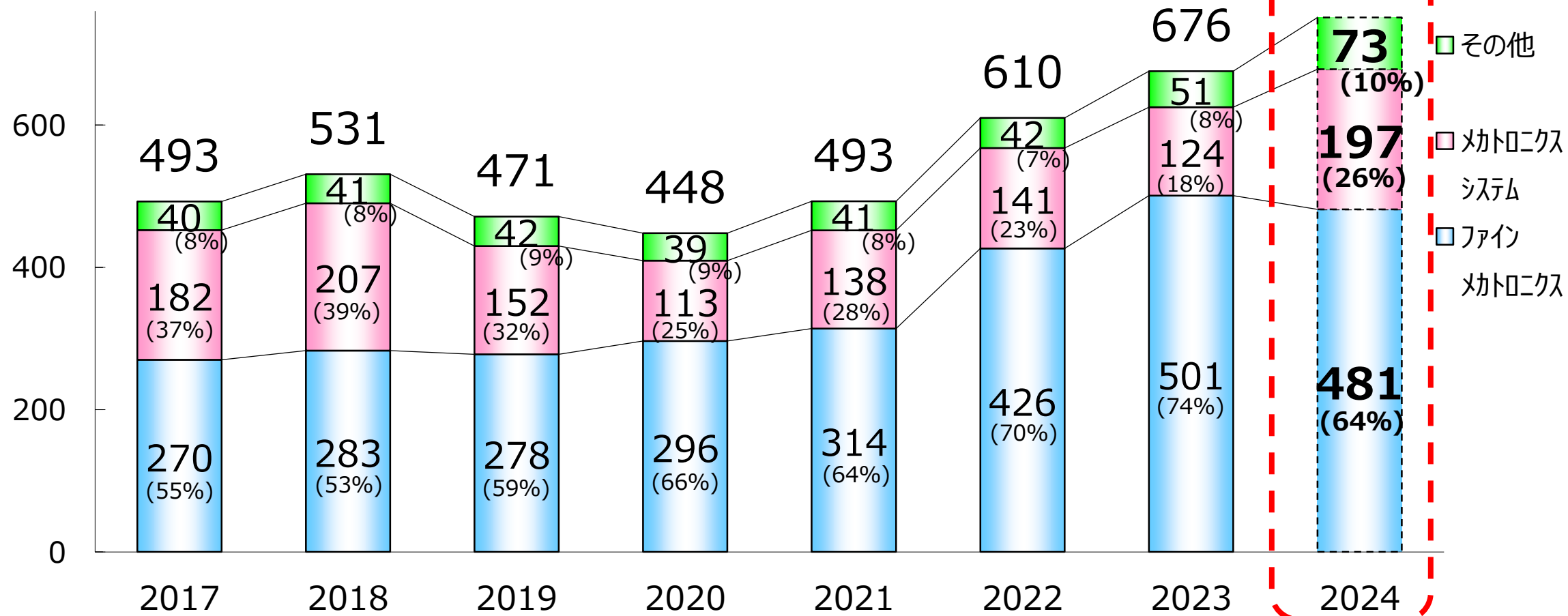
セグメント別売上高

ファインメカトロニクス 64%
メカトロニクスシステム 26%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

(億円)



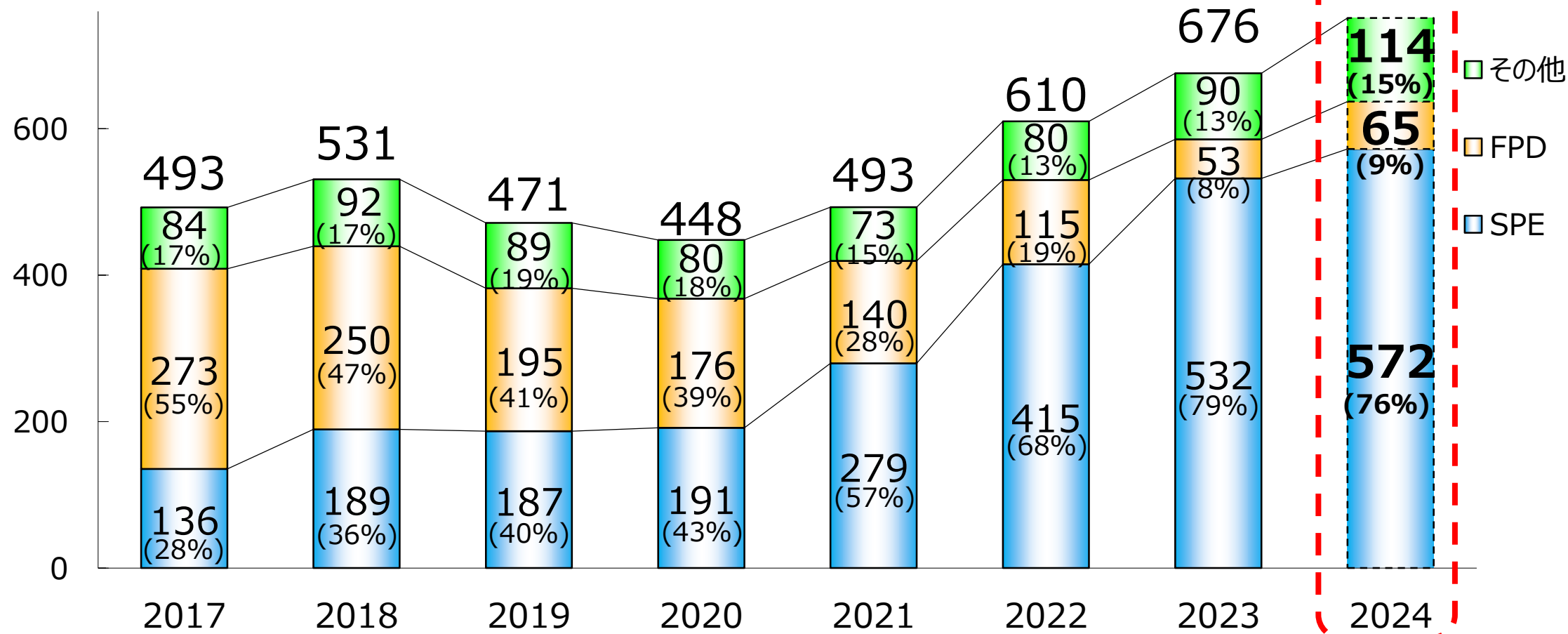
業績推移及び2024年度予想 (2)

* SPE : 半導体前・後工程装置
 FPD : FPD前・後工程装置

分野別売上高

SPE分野 76%

(億円)



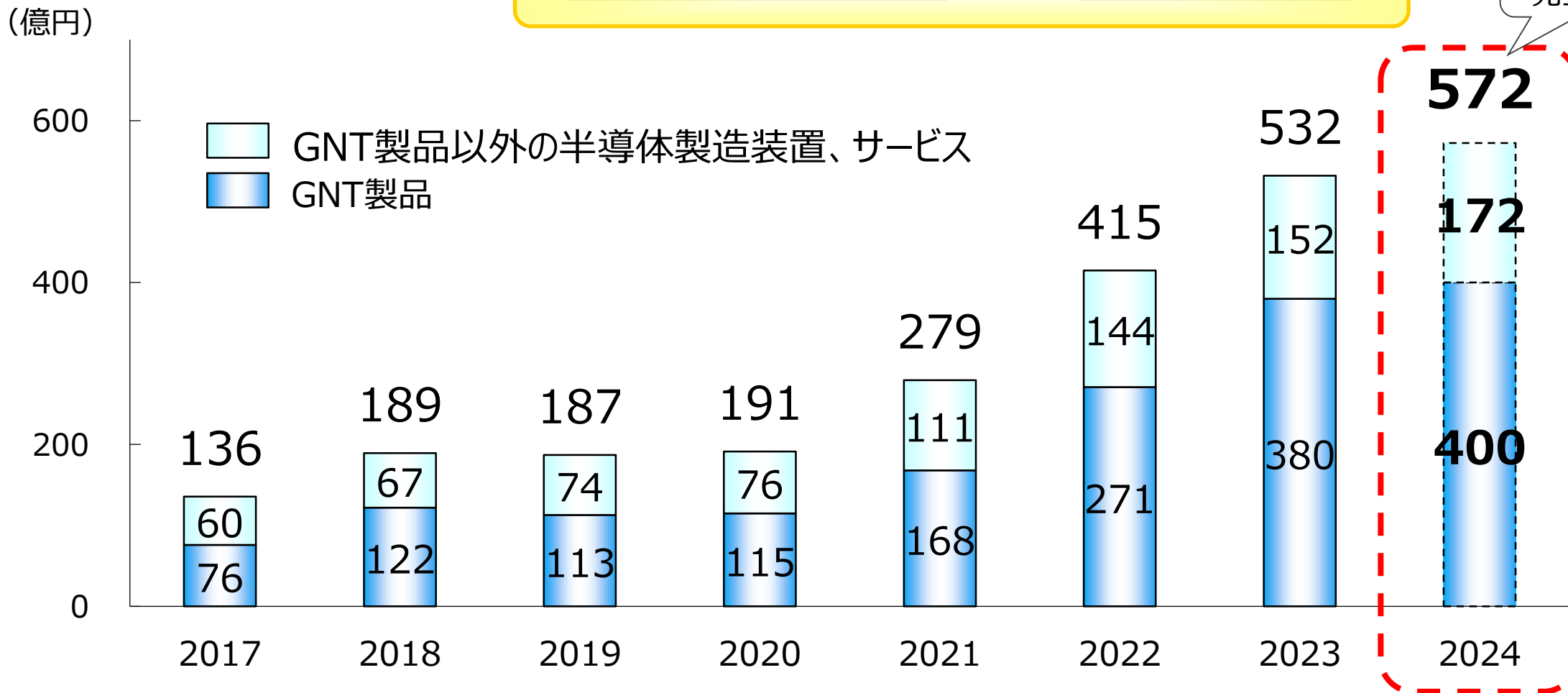
業績推移及び2024年度予想 (3)

*2024年度：予想

SPE分野売上高

SPE分野の着実な成長とともに、GNT製品も拡大

SPE分野
売上高計

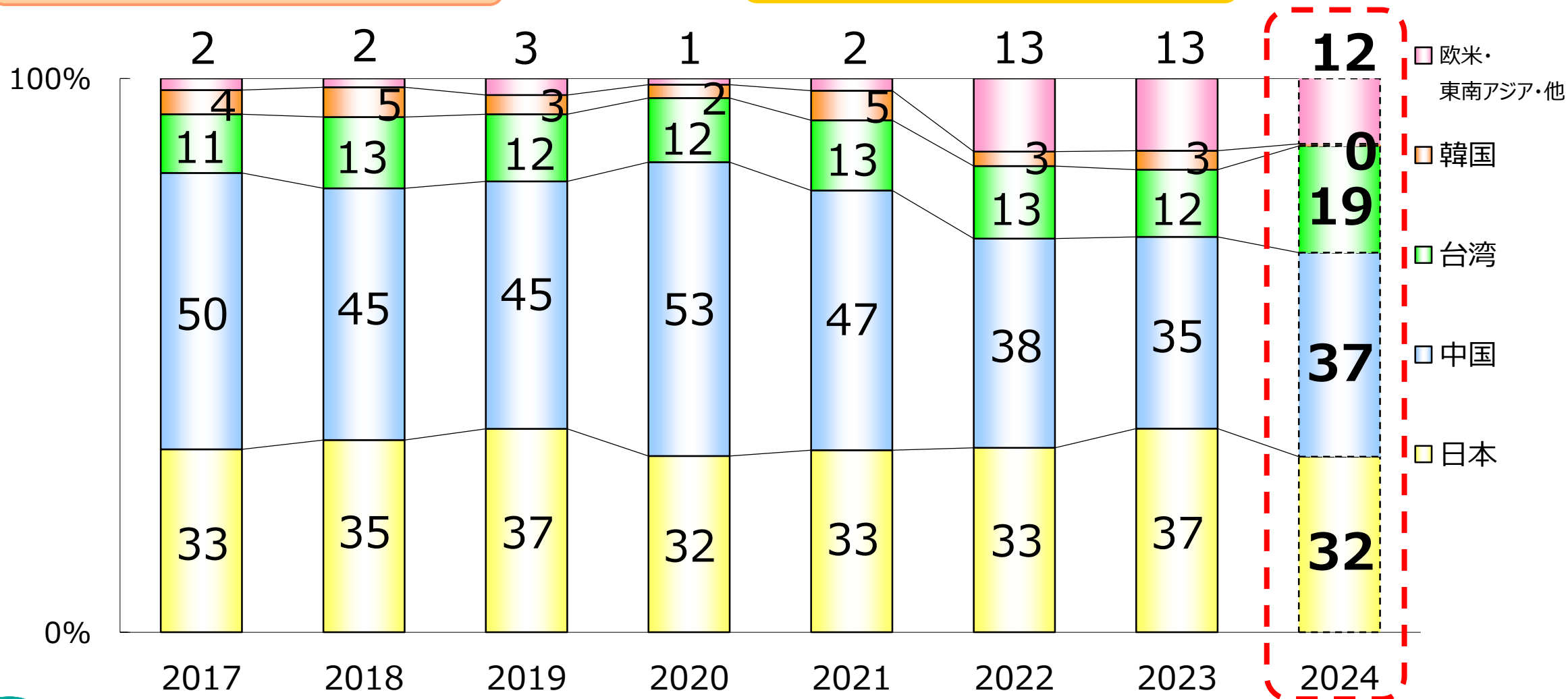


業績推移及び2024年度予想 (4)

地域別売上高比率

海外向け68% (中国37%)

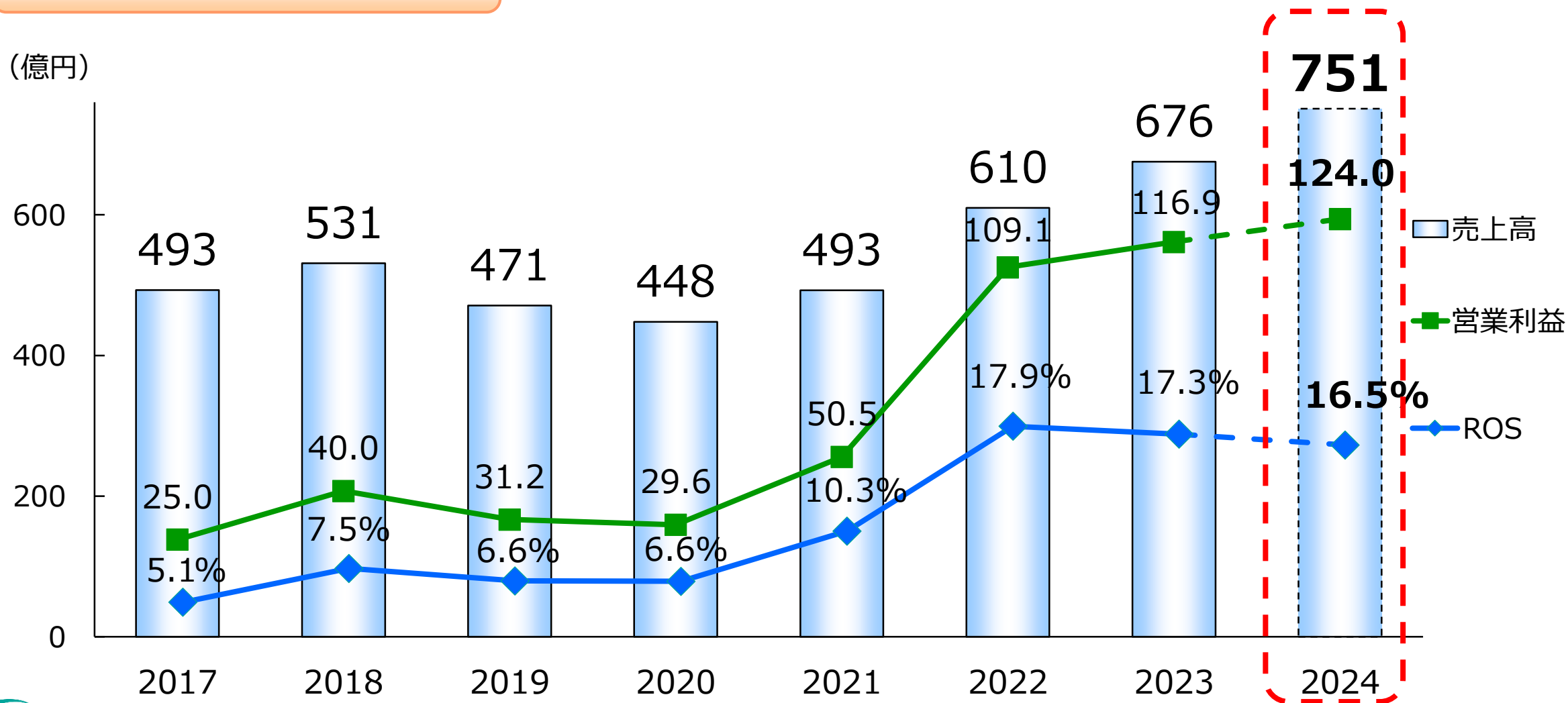
* 仕向地で区分



業績推移及び2024年度予想 (5)

売上高・利益・ROS

(億円)

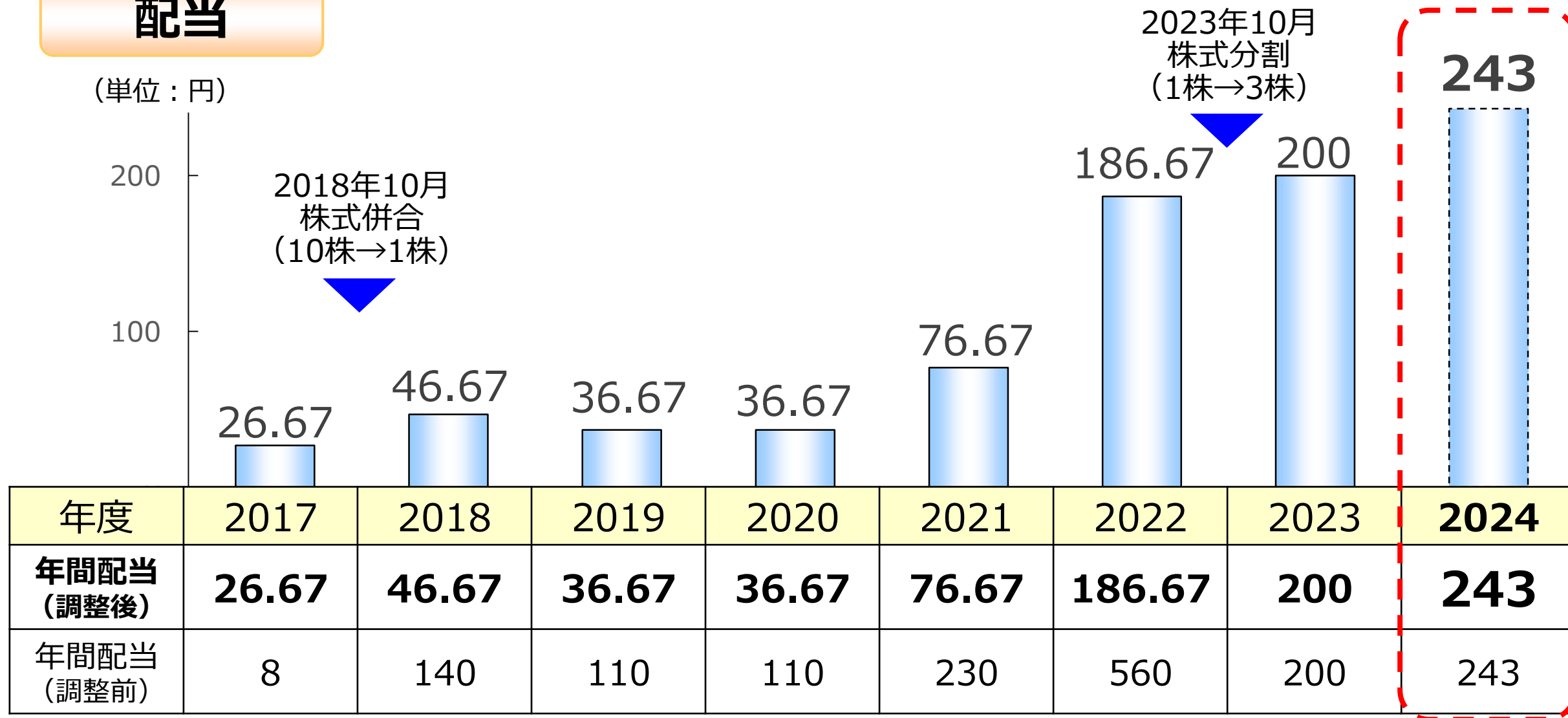


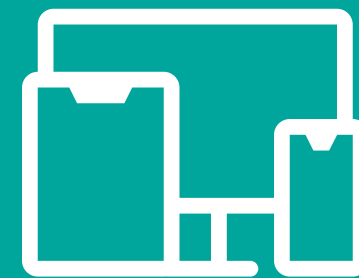
業績推移及び2024年度予想 (6)

* グラフは調整後金額

配当

(単位：円)





03

長期ビジョン及び中期経営計画

長期ビジョン「芝浦ビジョン2033」(1)

当社として捉える社会変化・課題

市場

- IoT、(Beyond) 5G、AIやAR、VRなどデジタル社会の進展に伴う半導体・FPD等市場の拡大

技術

- 先端性の高い半導体の開発・製造
- 技術者の育成、確保

環境

- カーボンニュートラル、環境負荷への配慮
- 資源の有効利用

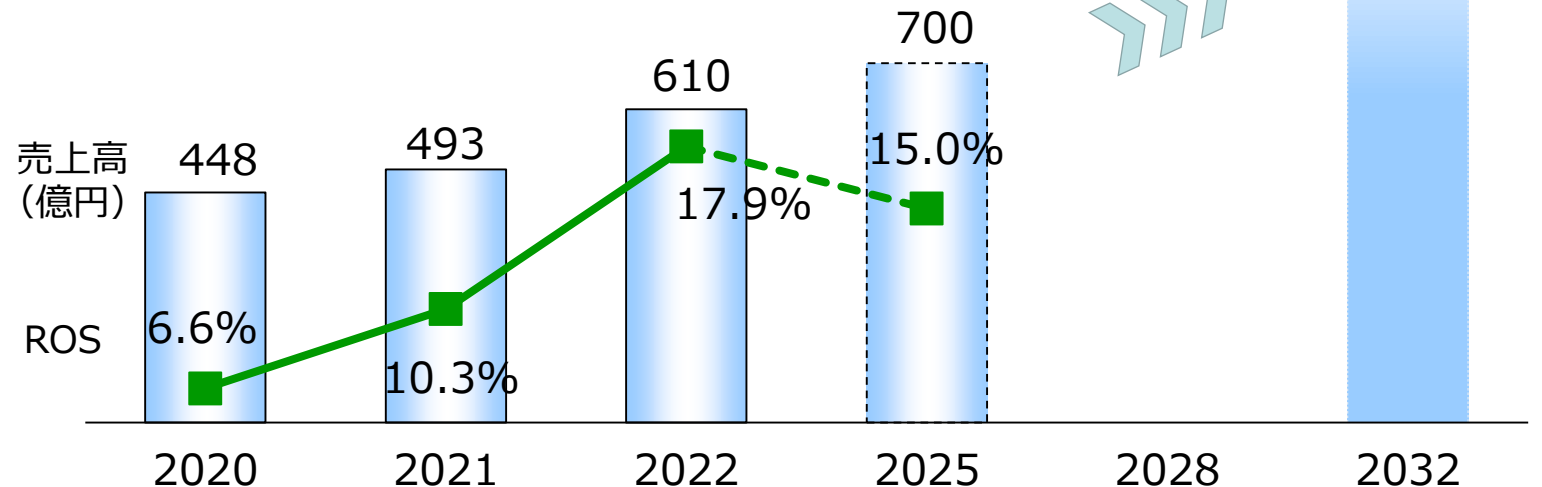
安定供給

- 半導体需要の高まり・確保、供給力不足
- 求められる機能の多様化、高度化
- 地政学的リスクへの懸念

10年後のありたい姿

**社会やお客様の将来課題とそこにある潜在的ニーズを把握して
能動的に提案・解決し、お客様と共に成長する企業**

ビジョン期間内で
・売上高1,000億円以上
・ROS20%以上
を目指す



長期ビジョン「芝浦ビジョン2033」(2)

ビジョン達成に向けた4つの重点的取り組み

2023年度実績

ポート フォリオ

- SPE : グローバル ニッチトップ(GNT)製品拡大を核に更なる拡大
- FPD : 新型・次世代向け製品を拡大

- SPE : 分野別比率79%、
SPE分野の内GNT比率71%
- FPD : 顧客との評価が着実に進行

技術

- 課題・ニーズの把捉と、解決に繋がる技術開発、製品・サービスへの展開
- 製品とサービスのより一体的な提案により、全体付加価値向上

- 顧客層拡大し、受注・評価実績増加
- 顧客への付加価値に立ち返り、製品・サービス一体提案の具体化検討開始

人財

- ビジョン達成を担う人財力強化、持続的成長に向けた積極採用
- DX推進を含む業務生産性向上

- 「芝浦ビジョン2033」を実現する人財像の策定
- 評価制度の見直し実施

財務

- 成長性と資本効率の両面を意識した、財務規律の堅持
- 事業成長・株主還元を重視した、キャッシュアロケーションの実現

- 自己資本比率40.3% ('23/3) → 42.4% ('24/3)
- 配当性向30%→35%に引上げ('25/3月期～)

中期経営計画方針

2023.4.1 – 2033.3.31

芝浦ビジョン2033達成

2023-2025
芝浦ビジョン2033
Phase.1

2026-2028
芝浦ビジョン2033
Phase.2

2029-2032
芝浦ビジョン2033
Phase.3

「持続的成長に向けた投資」を柱として、
次の成長に向けた土台強化を進め
再び営業利益100億円超を目指す

2023年5月公表時点

<2025年度>

売上高	700億円
営業利益	105億円
R O S	15%
R O E	17%

4
つ
の
柱

- ① SPE分野の更なる拡大
- ② 持続的成長に向けた投資
- ③ 課題とニーズの把握
- ④ マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進

中期経営計画 当初目標値と進捗状況

- **2024年度予想**では、2023年5月公表の水準を**1年前倒し**で達成見込み
- **2025年度中計値（予想）**は、2024年度の達成状況と市場環境をもとに**今後再設定**

(単位：億円)	2023 年度実績	2024 年度予想	当初目標値：2023年5月 公表		
			2023	2024	2025
売上高	676	751	590	680	700
営業利益	116.9	124.0	73.0	95.0	105.0
R O S	17.3%	16.5%	12.4%	14.0%	15.0%
経常利益	116.1	121.0	-	-	-
当期純利益	87.9	91.0	-	-	-
R O E	24.5%	21.6%	15.0%	17.0%	17.0%

SPE分野の更なる拡大（主要製品）

Siウェーハ製造



枚葉式Siウェーハ
洗浄装置

フォトマスク製造



フォトマスク
エッチング装置

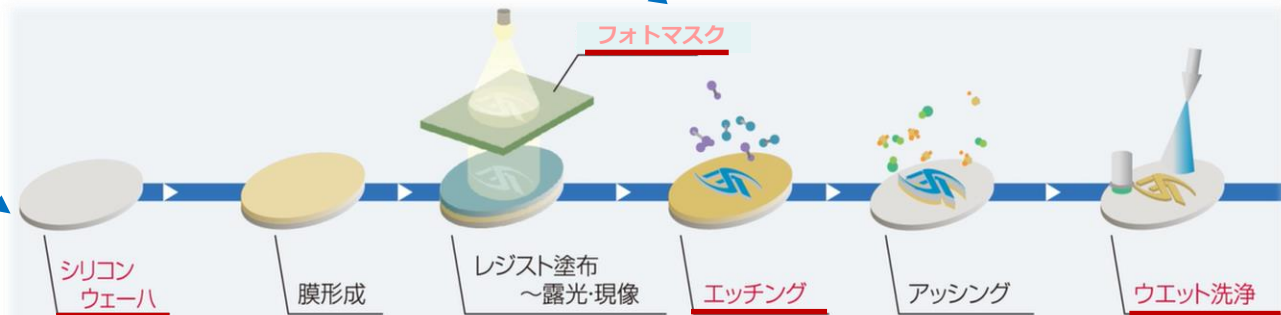


新製品

フォトマスク
洗浄装置



マスクブランク（基板）



前工程

後工程

モジュールプロセス



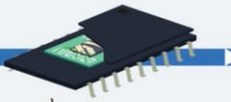
新製品

超高精度
ハイブリッドボンダ

ハイエンド
ウェーハレベル
パッケージボンダ



ボンディング

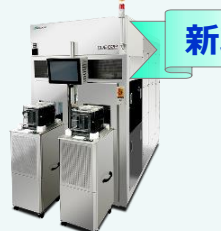


モールドイング



マーキング

その他の注目製品



新型ケミカルドライ
エッチング装置



FOSB/FOUP
洗浄装置

ウェーハプロセス （デバイス製造）



枚葉式リン酸
エッチング装置

2024年
4製品を上市

- 引き続き4工程の製品群をGNT製品群に位置付け
- GNT製品群を核としたSPE分野の拡大を追求
- 新しいGNT製品を創出



高精度2.5Dボンダ



高精度PLPボンダ

* いずれも環境調和型製品
* 当社グローバル ニッチトップ対象製品群（GNT製品）
が属す4工程（掲載機種は一例）

SPE分野の更なる拡大（主な取り組みと事例・進捗）

主な取り組み

GNT製品として実績の高い既存製品群の多面的（用途、顧客、エリア）拡大で一層のシェアアップ

継続的な新機種・新製品開発で、次世代GNT製品拡大の種まき

顧客、研究機関など外部との連携をより強化

生産増加にフレキシブルに対応可能な人員とエリアを確保

事例・進捗

- 先端ロジック／ファウンドリ向け枚葉式リン酸エッチング装置の用途、顧客拡大
- 生成AI向けGPU用途など先端パッケージ向けボンダの拡大

- 2024年度はGNT製品の上市に加え、GNT製品以外でも2機種を上市
- 次世代に向けた新機種・新製品開発を推進中

- 前工程、後工程とも複数の外部連携先と評価等継続中

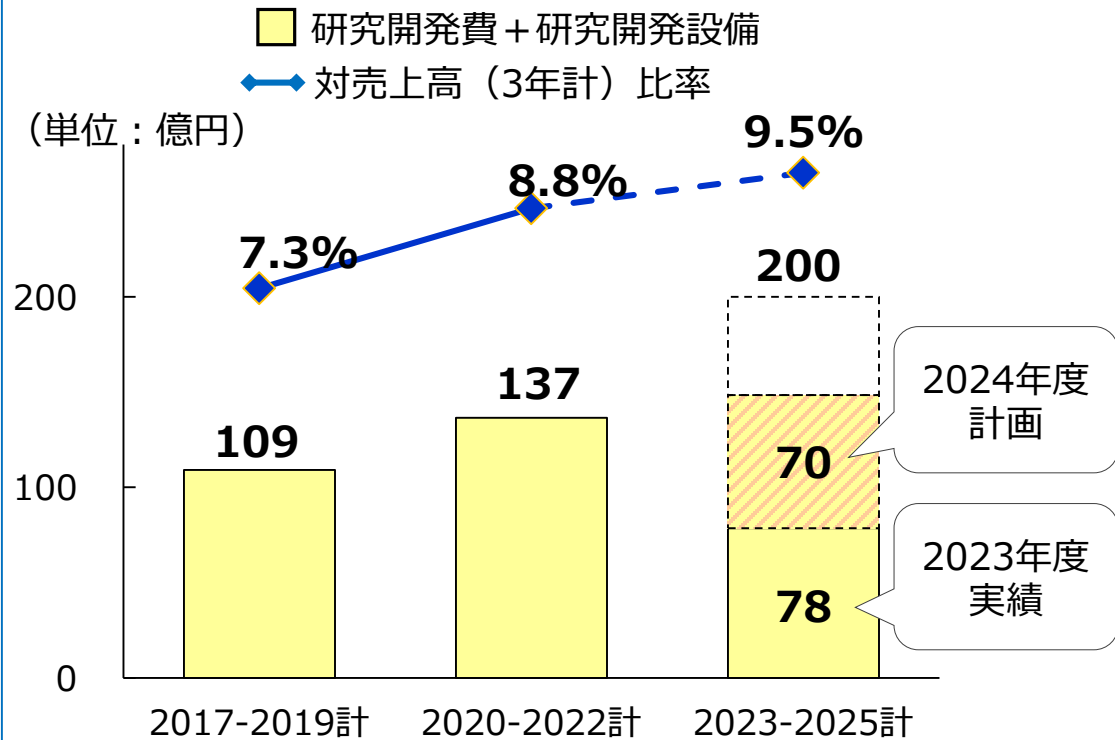
- 新棟建設、クリーンルーム増設（p.29）
- 積極的な人員増強と外部協力会社との連携強化を推進

持続的成長に向けた投資

研究 開発 関連

- 研究開発費はSPE分野への投入、注力継続
- より積極的な開発・評価体制の整備に向け、評価設備も強化
- 現中計期間 3年間で約200億円の投資を計画

■ 研究開発関連投資額・売上高比率推移（中計期間別）



人財

- 長期視点かつ積極的な採用・育成
- より生き生きと働くための制度・環境整備
- 教育・研修制度と内容を拡充

建屋 整備 ・ 拡充

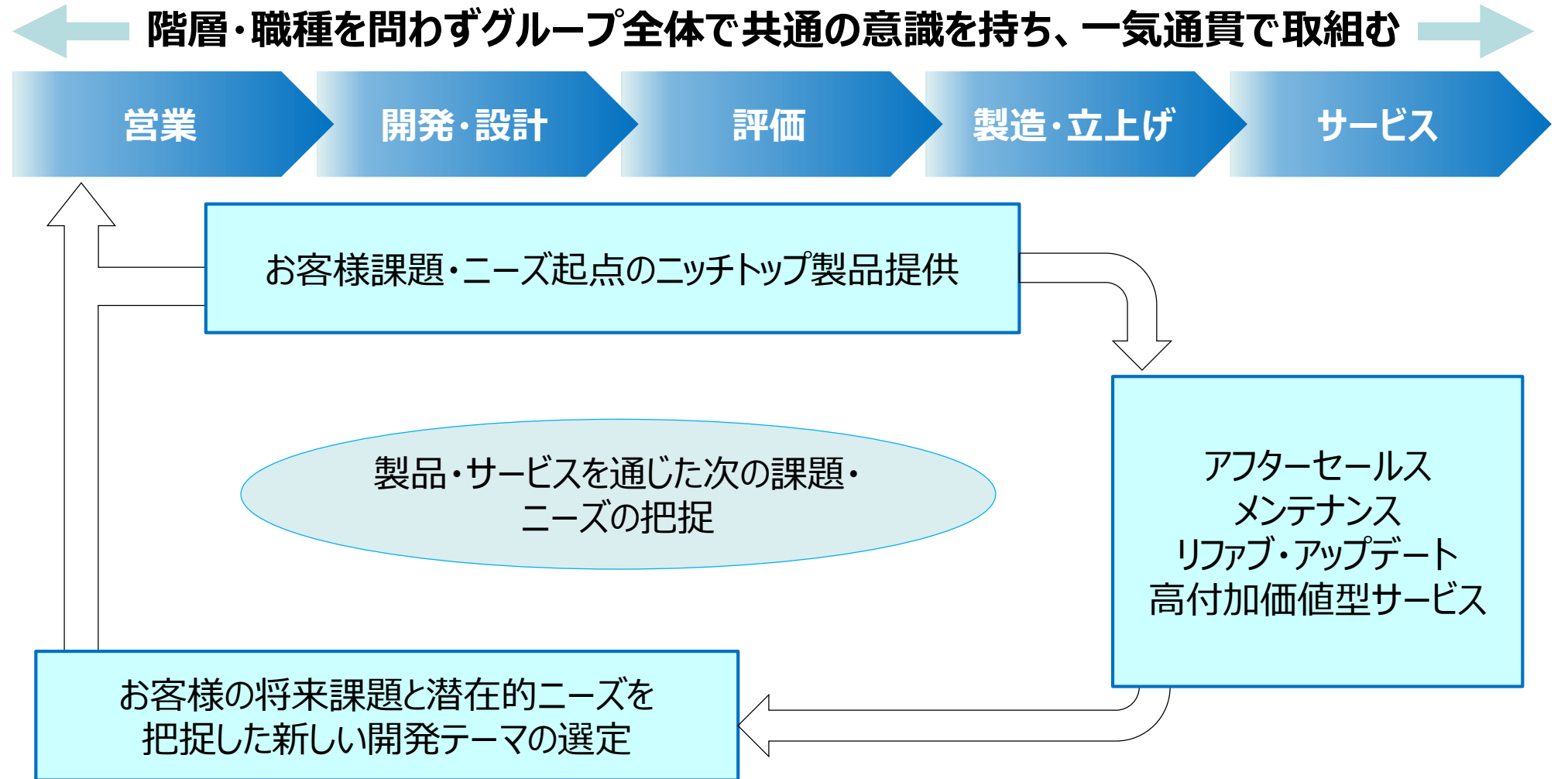
- 横浜事業所 研究開発新棟建設（2025年8月 竣工予定）

完成イメージ図
（3F、延床面積
約4,300m²）



- さがみ野事業所 クリーンルーム増設（2024年4月～稼働、650m²）

課題とニーズの把握



事業を通じて展開する4つのマテリアリティ

事業に直結するマテリアリティ（重点課題）への取組みを進め、
価値提供と利益創出の積み重ねにより人々の豊かな暮らしの実現と企業価値向上を目指す

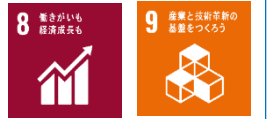
最先端技術の開発・提供で
デジタル社会に貢献

社会変化を見据えた最先端技術の開発・提供により、デジタルを活用したより豊かで創造的な社会を創出



研究開発・製造プロセスで産業
競争力の維持・向上に貢献

ものづくり人財の育成強化や知的財産の創出とマネジメントの深化により、グローバル展開する企業として産業競争力の維持・向上を実現



環境調和型製品の開発・提供で
グリーン社会に貢献

エネルギー使用量、原材料使用量を削減する技術・プロセスの開発を進め、当社製品ライフサイクルにおいて環境負荷を低減する製品の開発・提供を推進



品質・サービスで顧客の
安定稼働・生産性に貢献

製造装置について、グローバルでレジリエントな供給・稼働を実現し続け、顧客の継続的発展が維持されている



価値創出の基盤となるマテリアリティ

これまでのCSR活動をサステナビリティを巡る課題への対応として捉え直し、
マテリアリティに落とし込んだ活動により**中長期的な企業価値向上へ結び付く取組み**へと発展させる

気候変動への対応

- CO2排出量削減 50%
(2030年度までに2019年度比)



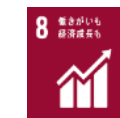
環境負荷の低減

- 廃棄物削減（再資源化率99%以上）
- 環境調和型製品 売上高比85%



多様な人財が活躍できる環境づくり

- 中核人財の登用における多様性確保
(2033年度までに女性管理職10%)



サプライチェーンマネジメントの強化

- 信頼関係に根付いたパートナーシップと開かれた機会の提供



ガバナンスの強化

- 取締役会の実効性の向上
- 積極的且つ能動的なサステナビリティ経営の推進



株主還元策について

当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として位置付けており、**業績に裏付けられた配当を維持**していくことを基本方針としております。

その実施につきましては、**業績及び財務状況等を総合的に勘案**し、連結配当性向は**おおむね35%を目途**としております。

<ご参考> これまでの連結配当性向基準とその適用期間（基準の公表開始以降）

2013～2019年度	2020～2021年度	2022～2023年度	2024年度～
25%	25～30%	30%	35%

株主還元策については、今後も引き続き検討してまいります。

その他トピックス（1）

- ブランドメッセージ：
「この先もずっと、人と技術で社会を支える。」



当社の強みである「技術力」「人」を活かし
「社会に貢献する」という思いを込めたメッセージ

- 統合報告書2024（毎年9月発行）



昨年2023年度から、従来の
CSR報告書に替え統合報告書を発行

その他トピックス (2)

■ 地域社会との連携

● 夏祭り開催



横浜、さがみ野の両事業所で夏祭りを開催。一般公開し、近隣からも多くの皆様にご参加いただいている。従業員の家族も集まり貴重な交流の場に。

● 自衛消防活動



当社敷地や近隣地域で火災が発生した際の初期消火のため、従業員による自衛消防隊を結成。訓練により技能の維持向上を図り、秋に行われる消防操法技術訓練会にも参加。

● 社会福祉法人との連携

横浜市内で自家製のお弁当やパン、お菓子、ジャムなどを販売する社会福祉法人による社内販売を実施。

● 小学生・中学生事業所体験

近隣地域の小学生や中学生が当社で職場体験をしたり、半導体やFPDについて学ぶ機会を提供。

その他トピックス (3)

■ PR活動事例

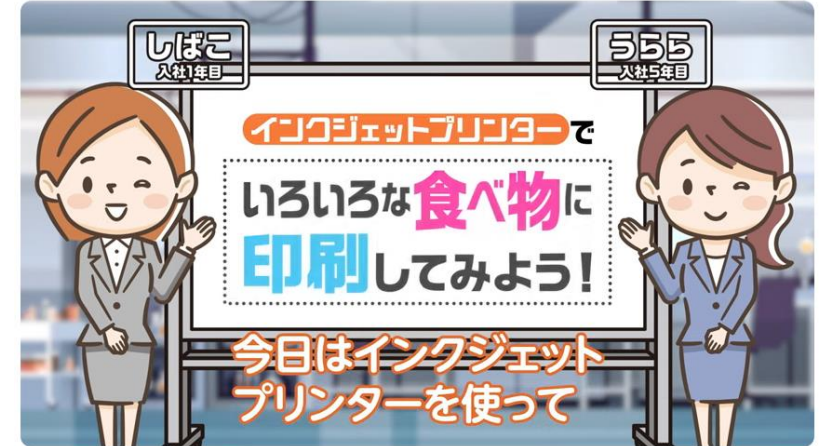
● リクルート広告



複数の大学の最寄駅の構内に広告開始



● YouTubeに動画公開



可食インクで新たな印刷の可能性を探求！インクジェット印刷機のご紹介

FPD分野で培ったインクジェット技術を活かし製品化した、錠剤（経口薬）への印刷装置の応用で、食べられるインクを食べ物に印刷する技術をご紹介します



その他トピックス（4）

■ TSMCから 2024 Excellent Production Support in Advanced Packaging を受賞



芝浦メカトロニクスグループは、2024年12月2日にTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (本社:台湾新竹市。以下、TSMC)からExcellent Production Support in Advanced Packagingを受賞しました。

Excellent Production Support in Advanced Packagingは、先端パッケージングでの卓越した生産支援においてTSMCと協力し、優れたパフォーマンスを発揮したサプライヤーに贈られます。

当社グループは昨年の「2023 Production Support Award」に続いての受賞となりました。

ご参考情報リンク先

芝浦メカトロニクスコーポレートサイト トップページ

🔗 <[芝浦メカトロニクス株式会社](#)>

投資家情報トップページ

🔗 <[投資家情報 | 芝浦メカトロニクス株式会社](#)>

IR資料室

🔗 <[IR資料室 | 芝浦メカトロニクス株式会社](#)>

芝浦ビジョン2033／中期経営計画

🔗 <[芝浦ビジョン2033／中期経営計画 | 芝浦メカトロニクス株式会社](#)>

サステナビリティ

🔗 <[サステナビリティ | 芝浦メカトロニクス株式会社](#)>

統合報告書2024

🔗 <[統合報告書／アニュアルレポート | 芝浦メカトロニクス株式会社](#)>

質疑応答

見通しに関する注意事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

芝浦メカトロニクスグループは、
「Smart」, 「Solutions」, 「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、豊かな社会の実現を支えてまいります。

